

kuraray

Noritake



LEVITÄ
JA JATKA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



VÄLITTÖMÄSTI TOIMIVA SIDOSAINE*

EI ODOTTELUA, TURHAA HANKAUSTA
TAI MONEN KERROKSEN LEVITYSTÄ.



Levitä**



Kuivaa



Valokoveta



* Noudata käyttöohjeita

** LEVITÄ hierovalla liikkeellä ja JATKA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Kuraray Noritake Dentalin valmistama CLEARFIL™ Universal Bond Quick on yleissidosaine, joka toimii välittömästi. Levitä sidosaine, anna sen kuivua ja koveta valolla. Muuta ei vaadita. Ei odottelua, useiden kerrosten levitystä tai sidosaineen hankaamista. Kuraray Noritake Dentalin pikasidosteknologian ansiosta CLEARFIL™ Universal BOND Quick varmistaa pitävän sidoksen yhdellä yksinkertaisella toimenpiteellä.

Tasalaatuinen tulos, optimaalinen pito

Kehittämämme sidosaineet ja sementit, kuten CLEARFIL™ SE BOND ja PANAVIA™, kuuluvat lajissaan innovatiivisimpiin ja edistyneimpiin ratkaisuihin. CLEARFIL™ Universal Bond Quickissa olemme yhdistäneet kaiken saatavillamme olevan asiantuntemuksen ja teknologian luodaksemme uudenlaisen sidosaineen, joka tarjoaa aiempaa nopeampia, tasalaatuisempia ja kestävämpiä tuloksia.

Odotuksenmukaisia tuloksia

CLEARFIL™ Universal Bond Quick -tuotetta käytettäessä sidosaineen levitys on yksivaiheinen ja suoraviivainen toimenpide. Unohda asettumisen odottelu, useiden kerrosten levitys ja aineen pitkälinen hankaus kaviteetissa. Nyt voit saavuttaa optimaalisen tuloksen vaivatta.

LEVITÄ JA JATKA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick sidostaa luotettavasti kaikki suorat täytteet ja pilarin rakentamisen, mutta myös epäsuorat täytteet ja korjaukset. Yhdessä pullossa toimitettavat, yleissidosaineet, joissa hyödynnetään ns. hitaita monomeereja, vaativat yleensä aikaa dentiinin läpäisyyn. Uuden Universal Bond Quick -sidosaineen kohdalla tämä ei ole enää tarpeen.



Pikasidosteknologia

Pikasidosteknologiassa MDP-monomeeri ja uudet hydrofiiliset amidimonomeerit yhdessä takaavat tasalaatuisen, kosteutta sietävän ja kestävän sidoksen. MDP-monomeeri muodostaa vahvan kemiallisen sidoksen hydroksiapatiittiin. Jo 20 vuotta käytössä ollut MDP on osoittanut arvonsa sidosratkaisuisissa.



Uusien amidimonomeerin hydrofiilisyyden takaa optimaalisen läpäisyn ennen kovetusta, ja kovetuksen jälkeen aine on ihanteellisen stabiili polymeerin verkkorakenteen ansiosta.



Preparoitu denttiini, jolla näkyy smear-kerros.

Hydrofiilisyyden takia myös sidosaineen tulee olla erityisen hydrofiilinen läpäistäkseen denttiin mahdollisimman hyvin



CLEARFIL™ Universal Bond Quick -aineella sidostettu denttiini.

Kovetuksen aikana CLEARFIL™ Universal Bond Quick muodostaa erittäin tiheän polymeeriverkkorakenteen. Verkon ansiosta sidoksen vedenimevyys on alhainen, mikä takaa pitkän kestävyyyden.

VAPAUTTA TOIMENPITEISIIN

CLEARFIL™ Universal Bond Quickin erinomaiset kovettumisominaisuudet mahdollistavat tiheän polymeeriverkon sidoksen sisällä. Tuloksena on luja sidosaine, joka muodostaa kestävästä sidoskerroksen, joka ei ime juuri lainkaan vettä.






Toisin kuin perinteiset sidosaineet, jotka vaativat odottelua, hankausta ja useita kerroksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi, CLEARFIL™ Universal Bond Quickin avulla toimenpiteet onnistuvat aina poikkeuksellisen nopeasti ja laadukkaasti.

Erinomaisen adheesion ansiosta jatkokorjauksia tarvitaan äärimmäisen harvoin. Koska odottelu ei ole tarpeen ja toimenpiteet sujuvat nopeammin kuin muilla sidosaineilla, sekä potilas että lääkäri ovat tyytyväisiä

SUORAT KOMPOSIITTITÄYTEET*



YLEISET sidosaineet

	CLEARFIL™ Universal Bond Quick Kuraray Noritake Dental	LEVITÄ hierovalla liikkeellä JA JATKA	Puhalla kevyellä ilmapuustauksella yli 5 sekuntia	Valokoveta 10 sekuntia**
	Scotchbond Universal*** 3M ESPE	Levitä ja hiero paikalleen 20 sekuntia	Puhalla kevyellä ilmapuustauksella 5 sekuntia	Valokoveta 10 sekuntia
	Prime & Bond active*** Dentsply	Levitä ja hiero kevyesti noin 20 sekuntia	Kuivaa ilmalla vähintään 5 sekuntia	Valokoveta 10–20 sekuntia
	Xeno Select*** Dentsply	Hiero sidosainetta 20 sekuntia	Kuivaa ilmalla vähintään 5 sekuntia	Valokoveta 10 sekuntia
	Adhese Universal*** Ivoclar Vivadent	Hankaa vähintään 20 sekuntia	Levitä ilmapuustauksella, kunnes pinta on kiiltävä ja liikkumaton	Valokoveta 10 sekuntia

* Noudata käyttöohjeissa kuvattuja tarkempia menettelyjä ja ohjeita

** 5 sekuntia tehokkaalla LED-valolla (valon voimakkuus yli 1500 mW/cm²)

*** Tavaramerkit kuuluvat kullekin mainitulle valmistajalle

Tiedot on kerätty valmistajien käyttöohjeista.

SUORAT KOMPOSIITTITÄYTTEET*

TOTAL-ETCH sidosaineet



CLEARFIL™ Universal Bond Quick
Kuraray Noritake Dental

LEVITÄ hierovalla liikkeellä JA JATKA

Puhalla kevyellä ilmapuustauksella yli 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia**



Adper Scotchbond 1 XT***
3M ESPE

Levitä 2–3 kerrosta, hiero kevyesti noin 15 sekuntia

Ohenna kevyellä ilmapuustauksella 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia



OptiBond Solo Plus***
Kerr

Levitä 15 sekuntia kevyellä sivelevällä liikkeellä

Ohenna ilmapuustauksella 3 sekuntia

Valokoveta 20 sekuntia



ExiTE F***
Ivoclar Vivadent

Levitä ja hiero vähintään 10 sekuntia

Hajota ohueksi kerrokseksi kevyellä ilmapuustauksella

Valokoveta 10 sekuntia



Prime&Bond NT***
Dentsply

Levitä ja anna vaikuttaa noin 20 sekuntia

Kuivaa suihkuttamalla puhdasta ja kuivaa ilmaa injektioiruiskusta vähintään 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia

SUORAT KOMPOSIITTITÄYTTEET*

ITSE-ETSAAVAT sidosaineet



CLEARFIL™ Universal Bond Quick
Kuraray Noritake Dental

LEVITÄ hierovalla liikkeellä JA JATKA

Puhalla kevyellä ilmapuustauksella yli 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia**



CLEARFIL™ S3 BOND PLUS
Kuraray Noritake Dental

Levitä ja anna vaikuttaa 10 sekuntia

Puhalla kevyellä ilmapuustauksella yli 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia



Adper Prompt L-Pop***
3M ESPE

Hiero 15 sekuntia painaen kevyesti. Levitä toinen kerros kuivumisen jälkeen

Kuivaa sidosaine kauttaaltaan ohueksi kerrokseksi kevyellä ilmapuustauksella. Kuivaa sidosaine uudestaan ohueksi kerrokseksi kevyellä ilmapuustauksella

Valokoveta 10 sekuntia



OptiBond All-In-One***
Kerr

Levitä kahdesti sivelevällä liikkeellä 20 sekuntia kerrallaan

Kuivaa kevyellä ilmapuustauksella ja sitten keskivoimakkaalla ilmapuustauksella vähintään 5 sekuntia

Valokoveta 10 sekuntia

OHUT KERROSPAKSUUS

CLEARFIL™ Universal Bond Quick koostuu ohuesta vain 5–10 µm paksusta kerroksesta, joka takaa esteettisen lopputuloksen vaativimmissakin etuhampaiden korjauksissa. Uutena innovatiivisena ratkaisuna mukaan lisätyt hydrofiiliset amidimonomeerit muodostavat tiheän polymeeriverkon ja parantavat näin ohuen kalvon stabiiliutta.

Tämän ansiosta sidosainekerros kestää kosteutta ja etenkin etuhammaspaikkojen reunat saadaan näyttämään siisteiltä.



Ennen



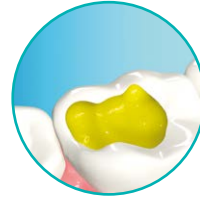
Jälkeen



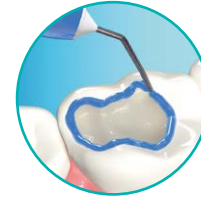


AIDOSTI YLEISKÄYTTÖINEN SIDOSAINE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick tekee suorien komposiitti- ja kompomeeritäytteiden käytöstä helppoa. Voit vapaasti valita itse-etsauksen, selektiivisen etsauksen ja total-etch-tekniikan välillä. Mihin tahansa päädytkin CLEARFIL™ Universal Bond Quick takaa optimaalisen lopputuloksen ilman turhaa odottelua. Levitä aine ja jatka seuraavan vaiheeseen.



Itse-etsaus
(ei fosforihappoa)



Selektiivinen etsaus
(fosforihappoa kiilteen pinnalle)



Total-etch
(fosforihappoa kiilteen ja dentiinin pinnalle)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick -sidosaainetta voidaan käyttää lähes kaikkien komposiittimateriaalien kanssa ja myös tapauksissa, joissa kaksoiskovetteiset materiaalit ovat tarpeen – esim. nastan ja pilarin sementoinnin yhteydessä. Kaksoiskovetteisten materiaalien kohdalla mukaan on sekoitettava CLEARFIL™ DC ACTIVATOR -aktiointiainetta, mutta tämä ei ole tarpeen CLEARFIL™ DC CORE PLUS- tai PANAVIA™ SA Cement Plus -tuotteita käytettäessä. Aine on myös erinomainen pintakäsittelyratkaisu epäsuorien materiaalien, kuten zirkonian, lasikeramiikan tai metallien, valmisteluun tai suunsisäisiin korjauksiin. Voit vain levittää aineen ja jatkaa eteenpäin.



SUORA



PILARIN RAKENNUS



EPÄSUORA

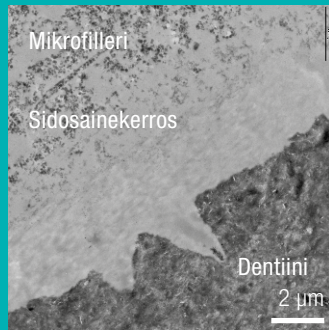


KORJAUS

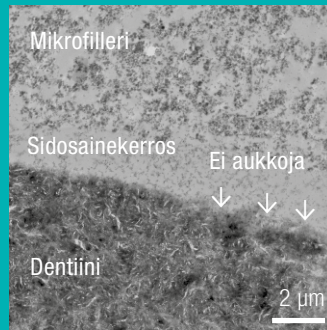
TUTKIMUS

Dentiinin optimaalinen sidostus

Uuden pikasidosteknogan ansiosta pystymme takaamaan nopean ja pitävän kiinnityksen kaikkiin materiaaleihin – myös erittäin haastavaan dentiiniin. CLEARFIL™ Universal Bond Quick -sidosaaineessa hyödynnetty pikasidosteknologia on todistettu erittäin tehokkaaksi. Tuloksena saadaan tiivis ja aukoton kiinnitys dentiiniin itse-etsaus- tai total-etch-menetelmää käytettäessä.



Etsaus ja huuhtelu TEM



Itse-etsaus TEM

UCL-DRIM-TUTKIMUS

Uuden sidosaineen (CLEARFIL™ Universal Bond Quick) kiinnitysteho dentiiniin

Tässä tutkimuksessa testattiin sidoslujuutta ihmisen dentiiniin ja komposiittimateriaalin välillä mittaamalla sidospinnan leikkausmurtolujuutta. Testaus kattoi kolme yleiskäyttöistä all-in-one-sidosaainetta ja kaksi itse-etsaavaa kaksikomponenttista sidosainejärjestelmää. Näytteitä säilytettiin 37-asteisessa tislatussa vedessä 24 tuntia.

Tutkimuksen suorittaja: UCL_DRIM, Louvain la Neuve, Belgia, 2016

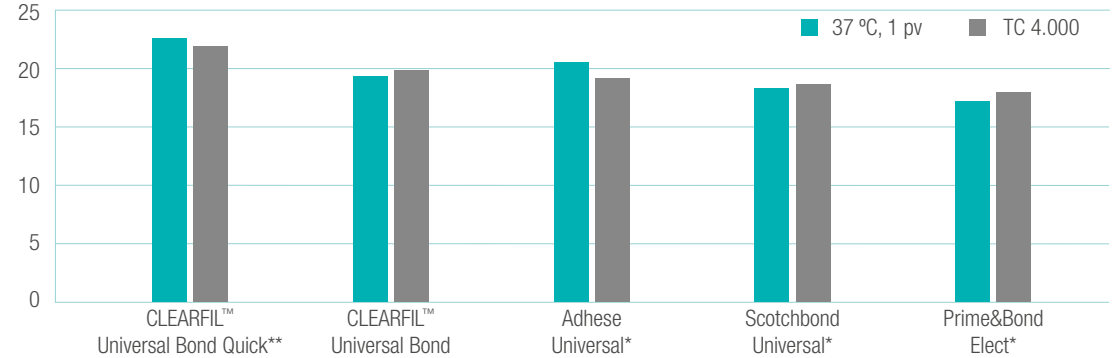
“Uusi CLEARFIL™ Universal Bond Quick -teknologia näyttäisi olevan yhtä tehokas kuin muut yleiskäyttöiset all-in-one-vaihtoehdot, vaikka odotusaikaa ei tarvita. Näin ollen se on kilpailijoitaan käyttäjäystävällisempi ja kätevämpi ratkaisu.”

Dr. Julian G. Leprince, Cliniques universitaires Saint-Luc UCL, Brysseli

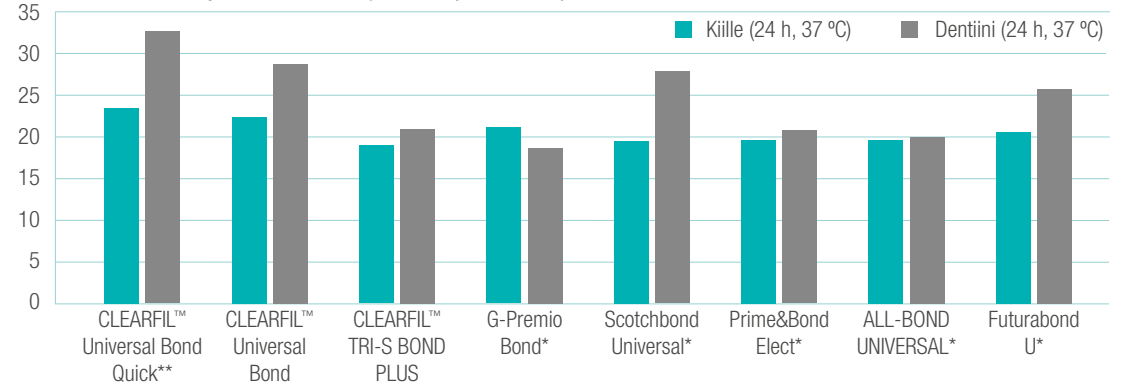
SIDOSLUJUUS

Kiilteeseen (total-etch) sekä kiilteeseen ja dentiiniin (itse-etsaus)

MPa Vetomurtolujuus naudan kiilteeseen (total-etch)



MPa Leikkausmurtolujuus naudan hampaaseen (itse-etsaus)



Kuraray Noritake Dental Inc. (Ultradent Method) * Ei Kuraray Noritake Dentalin tavaramerkki

**Tässä tutkimuksessa CLEARFIL™ Universal Bond Quick -ainetta levitetään kolmen sekunnin hierovalla liikkeellä..

LAAJA INDIKAATIOALUE

- ✓ Suora paikkaus valokovetteisella yhdistelmämuovilla
- ✓ Kaviteetin esikäsittele epäsuorissa korjauksissa
- ✓ Paljaiden juuripintojen käsittely
- ✓ Hypersensitiivisten hampaiden käsittely
- ✓ Lohjenneiden täytteiden suunsisäiset korjaukset
- ✓ Nastojen sementointi ja pilarien rakennus
- ✓ Epäsuorien restoraatioiden sementointi

TEKNISET TIEDOT

Filmin paksuus:	5–10 µm
Filmin paksuus CLEARFIL™ DC Activator -aineella:	<1 µm
Työskentelyaika valonsuojalevyn kanssa:	7 min
Työskentelyaika CLEARFIL™ DC Activator -aineella:	90 s

Levitysaika suorassa korjauksessa

	Itse-etsaus	Total-etch/selektiivinen
Fosforihappoetsaus	-	10 s
Sidosaineen levitys	Levitä hierovalla liikkeellä; odotusaikaa ei tarvita	Levitä hierovalla liikkeellä; odotusaikaa ei tarvita
Ilmakuivaus	5 s	5 s
Valokoveta	10 s*	10 s*
Kokonaiskesto	15 s	25 s

5 s tehokkaalla LED-valolla (valon voimakkuus yli 1500 mW/cm²)



TUOTEVALIKOIMAT

VAKIOPULLOSARJA

#3571-EU-pullo (5 ml),
K-ETCHANT-ruisku (3 ml),
levityssivellin (x 50 kpl),
neulakärki (20 kpl),
sekoitusastia, valonsuojalevy



TÄYTTÖPULLO

MD162801-EU-pullo (5 ml)



SÄÄSTÖPAKKAUS PULLOJA

#3574-EU-PULLO (3 X 5 ML)



VAKIOYKSIKKÖPAKKAUS

#3577-EU-annosyksikkö (50 kpl x 0,1 ml),
K-ETCHANT-ruisku (3 ml),
levityssivellin (50 kpl),
neulakärki (20 kpl)



CLEARFIL™ DC ACTIVATOR

MD129842-EU-pullo (4 ml)



K-ETCHANT-RUISKU

#3252- EU K-ETCHANT-ruisku (2 x 3 ml),
neulakärki (40 kpl)

Neulakärjet

#3253-EU-neulakärki (20 kpl)



Lisätietoja osoitteessa kuraraynoritake.eu/en/cubq



YHTEYSTIEDOT

Plandent Oy
Asentajankatu 6
00880 Helsinki



020 7795 200



www.plandent.fi



www.facebook.com/PlandentOy